

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 2 月 3 日 (2005.2.3)

【公開番号】特開 2004-111809 (P2004-111809A)
 【公開日】平成 16 年 4 月 8 日 (2004.4.8)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-014
 【出願番号】特願 2002-275177 (P2002-275177)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 3/34

H 0 1 L 21/60

【F I】

H 0 5 K 3/34 5 0 5 D

H 0 5 K 3/34 5 0 7 C

H 0 1 L 21/92 6 0 4 E

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 2 月 26 日 (2004.2.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ＩＣパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の端子上にハンダを印刷する際に用いるマスクであって、ハンダを通過させる開口を有し、該開口は前記基板上の端子よりも大きいことを特徴とするマスク。

【請求項 2】

請求項 1 において、前記基板にはハンダ・リフロー処理が施されることを特徴とするマスク。

【請求項 3】

請求項 1 又は請求項 2 において、

前記複数の基板側端子のうちの少なくとも一対の間には導電領域が形成され、

前記開口は当該一対の基板側端子の一方と前記導電領域とにまたがる大きさを有することを特徴とするマスク。

【請求項 4】

請求項 3 において、前記導電領域は前記基板側端子から延びる配線であることを特徴とするマスク。

【請求項 5】

ＩＣパッケージに備わる複数の端子に対応するように基板上に形成された複数の基板側端子の個々の上にマスクの開口を通してハンダを

供給する工程を有する配線基板の製造方法において、

前記ハンダは前記基板側端子の個々に対して当該基板側端子よりも広い領域に供給される

ことを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項 6】

請求項 5 において、前記基板上に供給されたハンダを溶融させるハンダ・リフロー工程をさらに有することを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項 7】

請求項 5 又は請求項 6 において、
前記基板側端子のうちの少なくとも一対の間には導電領域が形成され、
前記ハンダを供給する工程では、前記ハンダは 1 つの前記基板側端子の全部を覆い、且つ、
前記導電領域の幅方向の一部又は全部を覆うように前記基板上に供給される
ことを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項 8】

請求項 7 において、前記導電領域は前記基板側端子から延びる配線であることを特徴とする配線基板の製造方法。

【請求項 9】

請求項 5 から請求項 8 のいずれか 1 つに記載した配線基板の製造方法を用いて製造されたことを特徴とする配線基板。

【請求項 10】

請求項 5 から請求項 8 のいずれか 1 つに記載した配線基板の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする電気光学装置の製造方法。

【請求項 11】

請求項 10 に記載した電気光学装置の製造方法を用いて製造されたことを特徴とする電気光学装置。

【請求項 12】

請求項 10 に記載した電気光学装置の製造方法を実施する工程を有することを特徴とする電子機器の製造方法。

【請求項 13】

請求項 12 に記載した電子機器の製造方法を用いて製造されたことを特徴とする電子機器。